

证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2017-102

木林森股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	木林森	股票代码	002745
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李冠群	甄志辉	
办公地址	广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号		广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号
电话	0760-89828888 转 6666		0760-89828888 转 6666
电子信箱	ir@zsmls.com		ir@zsmls.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,624,239,645.51	2,086,783,820.98	73.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	306,124,796.02	152,617,282.02	100.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	292,690,691.04	148,654,260.51	96.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	508,051,894.58	143,099,262.78	255.03%
基本每股收益（元/股）	0.58	0.34	70.59%
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.34	70.59%
加权平均净资产收益率	5.66%	5.16%	0.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增

			减
总资产（元）	18,885,560,303.37	13,923,243,752.51	35.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,468,354,423.33	5,252,041,695.57	4.12%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,560		报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）		0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
孙清焕	境内自然人	67.32%	355,660,700	355,660,700	质押	262,500,000
天弘基金－广州农商银行－华鑫国际信托－华鑫信托 086 号证券投资集合资金信托计划	其他	4.62%	24,384,148	0		
建信基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托 051 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.87%	15,173,152	0		
中山市小榄镇城建资产经营有限公司	境内非国有法人	2.84%	14,999,900	0		
华富基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托 054 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.73%	14,423,420	0		
建信基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托 087 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.49%	7,857,908	0		
中山市榄芯实业投资有限公司	境内非国有法人	1.39%	7,320,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	4,041,790	0		
北京和聚投资管理有限公司－和聚平台证券投资基金	其他	0.75%	3,976,486	0		
中国工商银行股份有限公司	其他	0.67%	3,548,088	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	除中山市榄芯实业投资有限公司为股东孙清焕所控制的企业，未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动的情况。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司一直专注于LED封装及应用系列产品研发、生产与销售业务，是国内LED封装及应用产品的主要供应商，产品广泛应用于室内外照明、灯饰、景观照明、家用电子产品、交通信号、平板显示及亮化工程等领域。

目前，公司主要产品有SMD LED、Lamp LED、LED应用（包括照明产品及其他）三大类。公司依托技术研发实力，不断稳固LED封装市场地位的，同时逐步加大对LED应用的投入力度，向LED下游应用及其配套照明组件产业链延伸。

（一）公司主要系列产品介绍如下：

产品种类	小类	外观特性	应用领域
SMD LED	-	1、体积小、耐高温； 2、一般采用硅树脂进行封装； 3、主要用于照明及背光。	室内外照明、柔性灯带、电视背光、显示屏等
Lamp LED	-	1、体积小，直径2-12mm； 2、直插环氧封装； 3、防水、防震性较好； 4、外型可变化性较大，分为圆型、方型、三角型。	灯饰、指示灯、小家电、交通灯、LED显示屏等
LED应用	LED照明产品	-	日光灯、球泡灯、蜡烛灯、吸顶灯、灯丝灯、Par灯、筒灯、路灯等
	其他LED应用产品	-	LED显示屏、装饰灯饰、数码显示、点阵显示屏、特殊信息显示、广告牌等

（二）行业发展现状及公司所处的行业地位

LED封装行业向中国大陆转移明显，由中国引领的下一个新周期已经来临。经过前几年LED行业的发展，如今产业链从上至下，行业集中度提升明显；从去年至今年，上游芯片与封装行业的涨价潮也预示着行业景气度重新向上；下游以灯丝灯为代表的新应用，也将带来行业新一轮需求周期。根据LEDinside数据统计，2015年全球LED封装与模组产值达143亿美元，2016年产值预计增至147亿美元，增长率2.6%，预估2017年产值可达153亿美元，年成长率约5%。其中，2015年中国产值份额达21%，首次位列全球第一，具有历史性首次超越了日本。而根据DIGITIMES统计，2016年，中国厂商木林森首次位列LED封装厂营收排名榜单第四名，中国厂商的份额提升明显，与日韩厂商呈此消彼长的态势。

（三）报告期业绩驱动因素

报告期内，随着LED照明产品的价格趋于稳定，公司募投项目产能逐步释放，规模化效应明显提高从而促使产品的单位成本进一步下降，公司产品的市场竞争力不断增强，市场份额不断扩大。

2016年公司成功完成非公开发行股票，募投项目的逐步建设，生产设备及相关固定资产的投入增加，公司的资产规模及营销规模不断扩大，从而促使公司的业绩有明显增长。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。